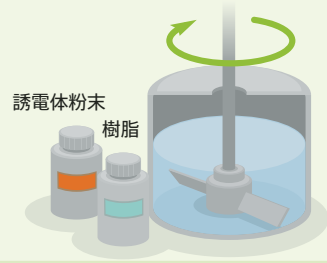


製造プロセス TDKの積層セラミックチップ コンデンサはこうしてつくられる

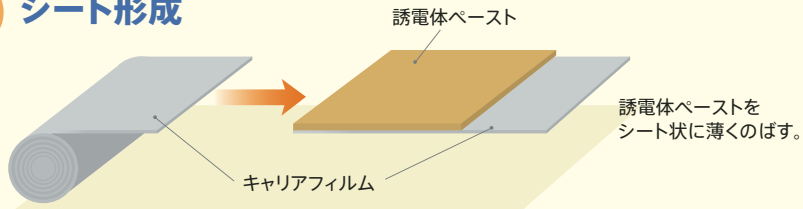
1 誘電体ペーストの製造



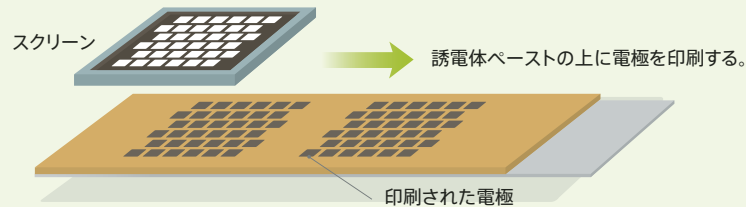
誘電体の粉末と樹脂を混ぜ合わせて、誘電体ペーストをつくる。



2 シート形成

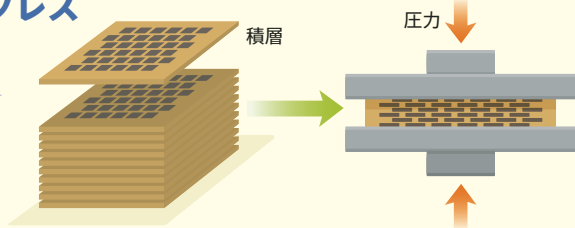


3 内部電極印刷



4 シート積層・プレス

電極が印刷された誘電体ペーストのシートを重ね合わせ、圧力をかける。

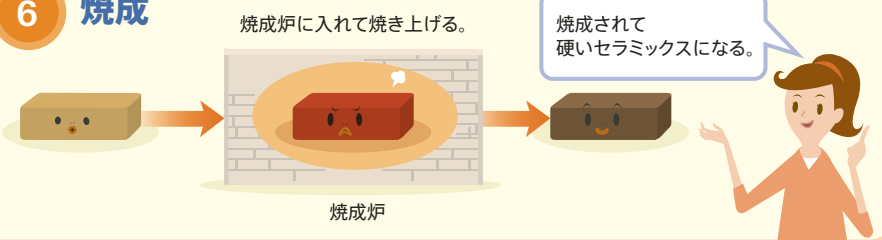


5 積層シートの切断・チップ化

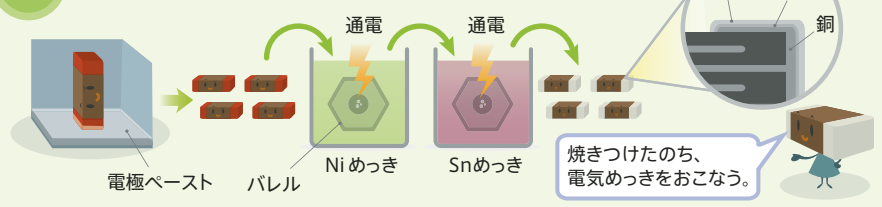


所定サイズにカットする。

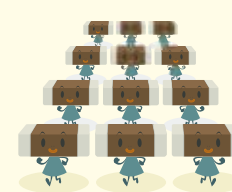
6 焼成



7 端子電極ペースト塗布・焼付・めっき



8 検査・梱包出荷



特性検査などを終えたのち、梱包・出荷される。

